

## 有机硅增粘剂

### SK-AP9176

#### 产品特性:

- 显著提高加成型硅胶对金属、聚烯烃等材质的粘接;
- 含“乙烯基”反应型。

#### 技术指标:

| 检测项目   | 典型数据      | 检测标准            |
|--|-----------|-----------------|
| 外观   | 微黄透明液体    | 目测              |
| 运动粘度 ( $\text{mm}^2/\text{s}@25^\circ\text{C}$ ) | 30~150    | GB/T 10247-2008 |
| 折光率 ( $25^\circ\text{C}$ )                       | 1.44~1.46 | GB/T 6488       |
| 乙烯基含量 (wt%)                                      | 6.0~7.0   | 硫代硫酸钠返滴定法       |

#### 典型应用:

- LED 封装硅胶: 促进苯基硅树脂对 PPA、镀银等材质的粘接;
- 有机硅离型剂: 提升离型剂对基材的锚固性能, 极小的离型力爬升;

#### 使用方法:

- 任意组分添加, 添加量为硅胶总量 0.5~2%;
- 建议  $100^\circ\text{C}$  以上固化硅胶, 固化时间视具体应用而定。

#### 包装贮运:

- SK-AP9176 按 5KG/桶, 20KG/箱包装;
- 请室温、通风、避雨防潮下保存;
- 本品非易燃易爆品, 按非危险品运输;
- 自生产日期起, 6 个月内使用最佳, 超期复检, 合格后方可使用。

#### 安全与环保:

- 使用本品前, 请确保佩戴相应的防护工具, 具体细则请阅读产品物质安全资料;
- 使用后的包装物, 请按当地固废法规处理。

#### 提示:

- 本文件所载是我司认为可靠的资料, 所载内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所改变。
- 本文件所提供的信息是我司在实验室和实践中所获得的认识, 具有一定的参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制, 所以务必在使用前进行应用测试评估。
- 产品的部分性能参数可根据客户的要求作专门调整, 如有需要, 可与技术部工程师联系。